

# HS-VSP

- 超低粗度銅箔であるHS-VSPは優れた絶縁特性と良好なエッチング特性を実現可能にする、環境に配慮した銅箔です。  
HS-VSP foil with very low profile to have excellent insulation result and good etchability, and comply with environment regulation.
- 超微細粗化処理はエッチング特性をより向上させます。  
Extra low profile to have excellent etchability.
- 安定したHS-VSPの供給能力はお客様のご要求を十分に満足いたします。  
Our plant has stable capacity for HS-VSP to fulfill customer requirements.

## 用途/Application

- ・高速伝送配線板  
/HSD (High speed digital)
- ・基地局 / サーバー  
/Base station / Server

## 構成/Composition

## 生産拠点/Production Site

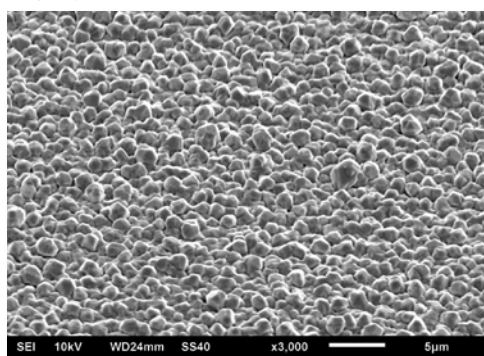
- ・台湾 / Taiwan

## 代表的特性値/Representative data

	$\mu\text{m}$	Rz ( $\mu\text{m}$ )	Tensile Strength (N/mm <sup>2</sup> )	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)
HS-VSP	18	1.8	350	8	0.9
	35	1.8	350	16	1.1
	70	1.8	350	19	1.3

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。  
This is representative data, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面/ Resist side

